

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为士兰集科提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）。士兰集科为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2025 年 5 月 19 日为士兰集科签署了合计担保金额为 3.56811 亿元的担保合同。

截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为 5.12 亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

公司于 2025 年 5 月 19 日与国家开发银行厦门市分行签署了 2 份《保证合同》，就参股公司士兰集科融资事宜按 27.447% 的持股比例提供连带责任保证担保，具体如下：

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限	是否有反担保	是否关联担保
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰集科微电子有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币 1.37235 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰集科微电子有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币 2.19576 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是

上述担保中，士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按61.987%的持股比例同时提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议和2025年5月9日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，同意公司按27.447%的持股比例为士兰集科向国家开发银行厦门市分行申请的两笔中长期贷款所分别对应的1.37235亿元和2.19576亿元贷款本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保。股东大会同时授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月24日和2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2025-016、临2025-018和临2025-022。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为5.12亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人士兰集科的基本情况

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C
成立日期	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路89号
法定代表人	裴华
注册资本	5,309,503,753元
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	芯片制造
经营期限	2018年2月1日至2068年1月31日
股权结构	厦门半导体投资集团有限公司持有61.987% 杭州士兰微电子股份有限公司持有27.447% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有10.566%
关联人关系介绍	公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为上市公司的关联方
关联人的资信状况	士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或

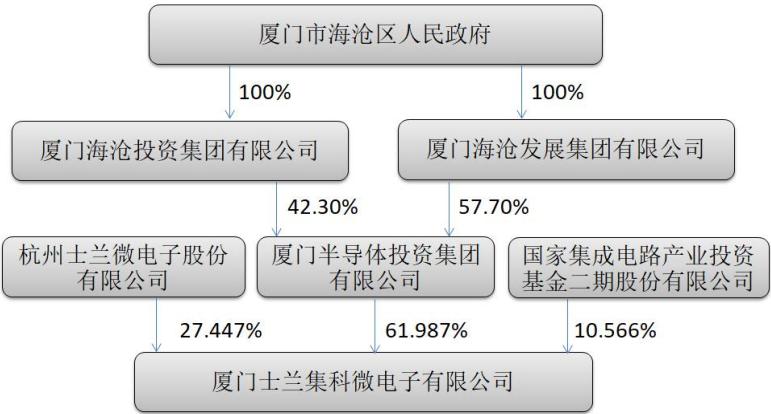
	有事项
--	-----

（二）士兰集科最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项目	2025年3月末/2025年1-3月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	929,114	931,541
负债总额	572,427	575,230
净资产	356,687	356,311
营业收入	74,415	256,140
净利润	376	-12,404
资产负债率	61.61%	61.75%

（三）截至目前，士兰集科股权结构如下：



三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限	是否有反担保	是否关联担保
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰集科微电子有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币1.37235亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰集科微电子有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币2.19576亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是

四、担保的必要性和合理性

士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司 12 吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保，有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款，为其 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障，从而为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进作用。被担保人士兰集科生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议和 2025 年 5 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2025-016、临 2025-018 和临 2025-022。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.658 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.29%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.69%；公司为参股公司士兰集科提供的担保总额为 9.284 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.60%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日